

展示会へのご招待

アジア最大級!
電子部品・材料、実装・検査装置、パワー・デバイスなどの最新技術を1,850社*が出演

第40回 ネプコン ジャパン

エレクトロニクス開発・実装展

会期 2026年1月21日水～23日金 10:00～17:00

会場 東京ビッグサイト

*同時開催展を含む見込み数



ご来場には事前登録が必要です(無料)

① 下記URLより来場登録

カンタン
登録!



② 登録後に発行される
来場者バッジをカラー印刷



③ 来場者バッジ提示で
そのまま展示会場に入場



受付に並ばず入場できます

『第40回 インターネプコンジャパン』出展のご案内

(総称 ネプコン ジャパン 2026)

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

当社は来る 2026年1月21日(水)～23日(金)に東京ビッグサイトにて開催される

『インターネプコンジャパン』へ内藤電誠グループとして出展する運びとなりました。

ご多用とは存じますが、弊社の製品・技術・サービスをご高覧賜りたく、ご案内申し上げます。

なお、今回より来場方法が変更になっております。下記QRコードまたはURLより事前の

来場登録をいただき、弊社ブースへお越しください。心よりご来場をお待ち申し上げております。

敬具

会期 : 2026年1月21日(水)～23日(金)

会場 : 東京ビッグサイト 東展示棟 東7ホール

ブース番号 : E36-59



来場者登録はこちら

◆事前来場登録 URL

<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1546729936894408-EFG>

【ブース位置】

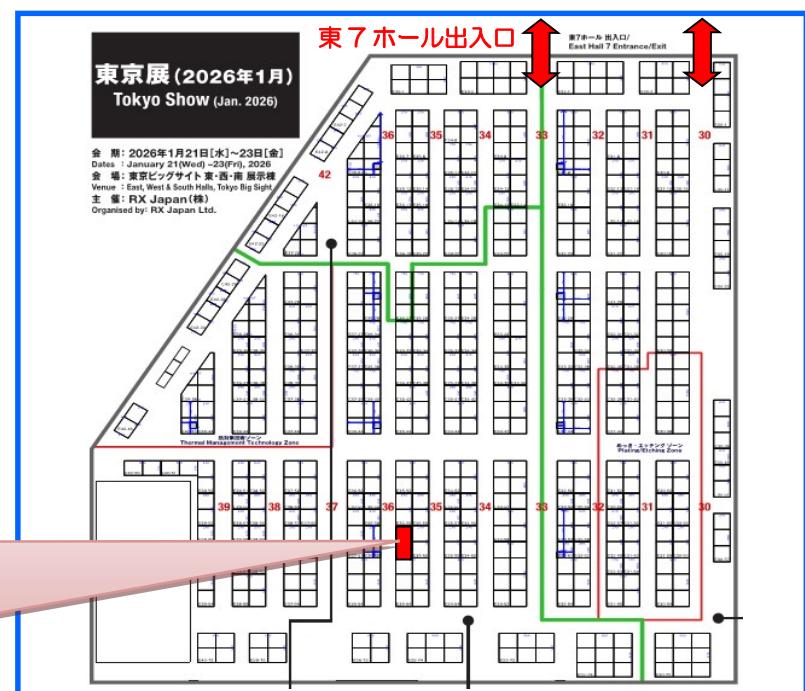


IC工房
e-Analog

Naito Denshi Kogyo Co., Ltd.

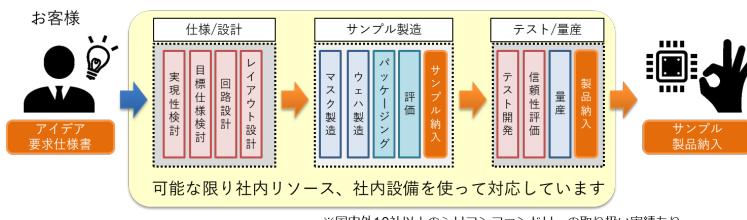


東展示棟 東7ホール
E36-59



【出展製品・サービス 一例】

● IC生産ターンキーソリューション



カスタム IC をご検討のお客様に、IC、LSI のターンキーサービスを提供しています。複数の国内外ファウンドリより、お客様のご要求に最適なプロセスやパッケージをご提案し、試作から量産対応まで承っております。

●半導体パッケージング サービス



試作、少量品から量産品まで、車載品にも対応した国内自社工場で、半導体パッケージの製造受託サービスを提供いたします。

- QFN、QFP、SOP系、DIP系 などの半導体パッケージング
- カスタム仕様の半導体パッケージ製造
- ダイシングやバーンインテストなど製造工程の一部やスクリーニングなど標準外作業

●信頼性評価・調査解析の受託サービス



各種信頼性試験・評価～調査解析まで一貫受託サービスで品質向上をサポート致します。

- ISO/IEC17025 試験所認定を取得し、国際標準規格での認定試験が対応可能です。
- 信頼性評価：各種環境試験(TC, HT, HHT, HHBT, PCT など)、
連続モニタ、リフロー耐熱性試験、染色評価、熱抵抗測定
- 業界トップクラスのX線CT装置でX線透過やCT観察で内部欠陥を可視化します。
- 物理解析：顕微鏡観察、X線CT観察、SAT観察、PKG開封、SEM/EDX、
断面加工、レーザー開封、ボンドブル・シェア強度試験、PIND試験

真偽調査：お客様が調達された製品(IC)をお預かりし、正規品(良品)と調査品(模倣品)の比較調査(非破壊・破壊)の検証を行います。

内藤電誠工業(株) インターネットコンピュータジャパン担当 行き

Fax. 044-431-7138

E-mail ml.ndkj.e-analog@ndk-grp.jp

■ ■ ■ アポイント連絡票 ■ ■ ■

ご都合の良いお時間を Fax.または E-Mail にてご連絡お願いいたします。
ご指定の日時に担当者が弊社ブース(受付)にてお待ちしております。

ご来場予定時間： 1月 日() 時頃

貴社名：

ご所属部署：

お役職：

ご芳名：

TEL :

FAX :

E-Mail :

ご商談対象のサービスへ ✓ をご記入願います。

- IC生産ターンキーソリューション
- 半導体パッケージング
- 信頼性評価・調査解析

商談内容やご要望、弊社担当者のご指名などご記入願います。(適任者選定の参考とさせて頂きます。)